



深圳市华能智研电子有限公司

Shenzhen Halnziye Electronics Co.,Ltd.

HY810 系列 导热界面材料

Series Thermal Interface Material

专为电子零部件降温设计的导热界面材料
Special Design for Electronic Components Heat Transfer

| 项目 Items | HY810 | HY810A | HY810B | HY810C HY810L | 单位Unit |
|-------------------------------|------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|
| 颜色 Color | 灰色 Grey | 灰色 Grey | 灰色 Grey | 灰色 Grey | No |
| 热传导系数 Thermal Conductivity | 3.0 ~ 4.85 | | | | W/m-k |
| 热阻抗 Thermal Impedance | <0.0087 | <0.016 | <0.037 | <0.057 <0.007 | °C-in ² /W |
| 比重 Specific Gravity | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 2.94 | g/cm ³ |
| 浓度 Thixotropic Index | 330±10 | 330±10 | 330±10 | 350±10 300±10 | 1/10mm |
| 瞬间耐温度 Moment Bore Temperature | -50-280 | -50-280 | -50-280 | -50-280 -50-350 | °C |
| 工作温度 Operation Temperature | -30-230 | -30-230 | -30-230 | -30-230 -30-300 | °C |

成份 Ingredients

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|-----------|----------|------------|-------------|
| 矽化合物 Silicone Compounds | 15% | 15% | 20% | 30% 18% | % |
| 碳化合物 Carbon Compounds | 35% | 30% | 30% | 30% 25% | % |
| 氧化金属化合物 Metal Oxide Compounds | 50% | 55% | 50% | 30% 57% | % |
| 包 装 Package | 软管 ST | 迷你包 SP | 针管 TU | 罐装 CN | 吊卡 Other |
| | 20g-25g | 0.5g-5g | 0.5g-30g | 10g-1000g | 0.5g-5g |

产品图片 Products Pictures

| ST | SP | TU | CN | Other |
|----|----|----|----|-------|
| | | | | |

执行标准: Q/HYTG 001-2017

※本产品耐温, 阻燃, 一般常温储存方式即可

Thermal Interface Materials Temperature Resistant, Flame Retardant and Storage at room temperature

以上数据由深圳市华能智研电子有限公司实验室测试所得, 该实验室保留最终解释权

All data above are provided Shenzhen Halnziye Electronics Co.,Ltd. Halnziye All Rights Reserved